

智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊 114 年 2 月號

目 錄

1140201 有關第 108211337N01 號「壓合治具」新型專利舉發事件（112 年度行專訴字第 8 號）（判決日：112.8.24）.....	1
一、 案情簡介	1
（一）案件歷程.....	1
（二）系爭專利請求項 1 之內容.....	1
二、 主要爭點及分析檢討	2
（一）主要爭點.....	2
（二）智慧局見解.....	2
（三）法院判決見解.....	3
（四）分析檢討.....	4
三、 結論與建議	5
四、 附圖	6

1140201 有關第 108211337N01 號「壓合治具」新型專利舉發事件（112 年度行專訴字第 8 號）（判決日：112.8.24）

爭議標的：新型專利不具進步性

相關法條：專利法(108.5.1 修正公布)第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

證據 2 實已揭露其限高柱位於下模塊之外圍，並設於每一矩形之元件定位區各角隅處，且限高柱之支撐部可提供基板之四角隅部位抵靠，其限高柱之支撐部與系爭專利請求項 1 下模塊四個延伸支撐部之分布位置相同，兩者均具有支撐基板四邊角部位之作用功能；又證據 2 圖式 1 亦揭露其下模塊 111 及限高柱 12 相對應壓合位置之上模塊 22 四個凸部 222 分別形成於該上模塊之四個角隅處且朝外凸伸，上述結構即相當於系爭專利請求項 1 要件 1C 之「所述下模塊包括四延伸支撐部，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸」技術特徵。由是可知，系爭專利請求項 1 要件 1C 之技術特徵僅係將證據 2 「下模塊限高柱支撐部之結構」，以相對應壓合之「上模塊 22 四個凸部 222 分別形成於該上模塊的四個角隅處且朝外凸伸結構」作簡單替換並將上模塊大小相對應於下模塊之元件定位區，所屬技術領域具通常知識者依證據 2 所揭露之下模塊與限高柱支撐部結構，並參酌相對應壓合之上模塊與凸部結構，即可輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

（一）案件歷程：

原告（專利權人）於 108 年 8 月 27 日以「壓合治具」向智慧局申請新型專利，經處分准予專利（下稱系爭專利）。

（二）系爭專利請求項 1 之內容：

一種壓合治具，其包括一下模、設於該下模上方的一上模，以及設於該上模中能上下運動的至少一活動壓塊，該下模與能相對於該上模上下運動，其中：該下模包括：一下模本體，其界定有一載盤定位區間以及位於該載盤定位區間內

之至少一元件定位區：至少一下模塊，其係設於該下模本體的頂面且位於所述元件定位區內向上凸伸，所述下模塊包括一模塊基部以及四延伸支撐部，該模塊基部實質為一矩形塊體，該模塊基部之各周邊與其側鄰之所述元件定位區的邊界各具有一間距，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界；以及至少一氣流通道，其係設於該下模本體中且延伸至所述下模塊的頂面而形成一抽氣孔；該上模包括一上模板，該上模板中形成至少一通孔，所述通孔之數量及位置相對應於該下模的元件定位區；所述活動壓塊係能上下運動地設置於該上模之通孔中，且每一所述活動壓塊的位置對應其下方的一所述下模塊，所述活動壓塊底面與相應的下模塊的頂面平行且能上下相對位移。

二、 主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

1. 證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？
2. 證據 2、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二) 智慧局見解：

1. 關於系爭專利請求項 1，證據 2 雖未揭露系爭專利請求項 1「該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界」之技術特徵，惟證據 2 說明書第 [0016] 段已揭示多個限高柱 12 分布設置於下模塊 111 的外圍，並設於每一矩形的元件定位區 101 的各角隅處，限高柱 12 的支撐部 122 為提供半導體元件 80 的四角隅部位抵靠之用，與系爭專利請求項 1 之四個延伸支撐部分布位置相同且具有相同之作用。因此，系爭專利請求項 1「該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界」之技術特徵，僅是證據 2 之下模塊與限高柱支撐部組合的簡單變更，並未產生無法預期之功效，所屬技術領域具有通常知識者可由證據 2 所揭示技術內容簡單變更輕易完成系爭專利請求項 1 之創作，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 關於系爭專利請求項 1，證據 3 已揭示承載框部 121 概係一矩形的框體，其中承載框部 121 的四個角落能在半導體元件 40 放置於相對應的承載框部 121 上時，係用以支撐半導體元件 40 的四個邊角，且承載框部 121 的四個角落與複數定位擋部 122 係形成件定位區的邊界，可對應前述證據 2 所未揭露系

爭專利請求項 1 之差異技術特徵。由於證據 2、3 均屬壓合治具，具技術領域之關聯性，且證據 2、3 均是以上下相對之上模或壓板、下模或壓合基座等構件壓合半導體元件，具功能或作用之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者有動機將該等證據之技術內容予以組合，將證據 3 揭示之承載框部結合至證據 2，而能輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，是證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三) 法院判決見解：

1. 關於系爭專利請求項 1，證據 2 說明書第 7 頁第[0016]段已明載「如圖 1 至圖 3 所示，所述多個限高柱 12 分布設置於該模座本體 110 頂面之元件定位區 101 內且位於下模塊 111 的外圍，於本較佳實施例，所述限高柱 12 係設於每一矩形的元件定位區 101 的各角隅處，所述限高柱 12 頂端高於下模塊 111 的頂面，所述限高柱 12 頂端各具有一限高缺口 121 以及一位於限高缺口 121 底部的支撐部 122，支撐部 122 與下模塊 111 之頂面平行且位於高之位置，所述限高缺口 121 與所述支撐部 122 位於元件定位區 101 的範圍內」等語，其說明書第 12 頁第[0031]段第 6 至 7 行復揭露「且基板 81 四角隅部位分別抵靠在相應位置的限高柱 12 的支撐部 122 上」等特徵，是證據 2 實已揭露其限高柱位於下模塊之外圍，並設於每一矩形之元件定位區各角隅處，且限高柱之支撐部可提供基板之四角隅部位抵靠，其限高柱之支撐部與系爭專利請求項 1 下模塊四個延伸支撐部之分布位置相同，兩者均具有支撐基板四邊角部位之作用功能；又證據 2 圖式 1 亦揭露其下模塊 111 及限高柱 12 相對應壓合位置之上模塊 22 四個凸部 222 分別形成於該上模塊之四個角隅處且朝外凸伸，上述結構即相當於系爭專利請求項 1 要件 1C 之「所述下模塊包括四延伸支撐部，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸」技術特徵。由是可知，系爭專利請求項 1 要件 1C 之技術特徵僅係將證據 2「下模塊限高柱支撐部之結構」，以相對應壓合之「上模塊 22 四個凸部 222 分別形成於該上模塊的四個角隅處且朝外凸伸結構」作簡單替換並將上模塊大小相對應於下模塊之元件定位區，所屬技術領域具通常知識者依證據 2 所揭露之下模塊與限高柱支撐部結構，並參酌相對應壓合之上模塊與凸部結構，即可輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 原告雖主張系爭專利與舉發證據 2 解決之技術問題不同、解決技術問題所提出之技術特徵及技術功效亦有差異，系爭專利請求項 1 相較於證據 2 具備

進步性，證據 2 自不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性云云。惟查，原告自承證據 2「於半導體元件 80 之壓合製程中，半導體元件 80 受到上下夾擊的作用力，壓縮散熱片 82 與基板 81 之間間隙及擠壓導熱膠 83 擴散，直至下模 10 的每一限高柱 12 頂面同時接觸到上模塊 22 底面」等語，即已說明證據 2 之壓合製程直至下模 10 之每一限高柱 12 頂面同時接觸到上模塊 22 底面之前，基板 81 四邊角均受到上下夾擊之作用力，可知證據 2 實質上已提供解決系爭專利四個角隅產生翹曲問題之技術手段，差異僅在於證據 2「下模圍限高柱」結構，與系爭專利請求項 1 下模「四延伸支撐部，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸」結構不同，惟上述差異實為所屬技術領域具通常知識者依據證據 2 即可輕易完成，且未具無法預期之功效，是縱使證據 2 與系爭專利兩者發明所欲解決之問題或有不同，惟證據 2 確已揭露解決系爭專利四個角隅產生翹曲問題之技術手段，已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，原告前開主張自非可採。

3. 關於系爭專利請求項 1，證據 3 說明書第[0021]段、第[0013]段、第[0014]段已揭露於半導體元件放置在相對應之承載框部上時，其承載框部之四個角落能用以支撐半導體元件之四個邊角，且承載框部之四個角落與複數個定位擋部形成至元件定位區之邊界，故證據 3 承載框部的四個角落，即相當於系爭專利請求項 1 要件 1C 之「所述下模塊包括四延伸支撐部，該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界」技術特徵，亦即證據 2 與系爭專利請求項 1 於要件 1C 之差異部分已為證據 3 所揭露。而證據 2、3 均為壓合治具，具技術領域之關聯性，兩者均是以上下相對之上模或壓板、下模或壓合基座等構件壓合半導體元件，具功能或作用之共通性，所屬技術領域具通常知識者自有合理動機將證據 2、3 之技術內容予以組合，並將證據 3 揭露之「承載框部」用以簡單替換證據 2 之「下模塊限高柱支撐部」，即可輕易完成系爭專利請求項 1 之整體技術特徵，是證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四) 分析檢討：

1. 系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異在於四個延伸支撐部係延伸自模塊基部四個角隅處，兩者形成一體，而證據 2 之四個限高柱與下模塊互相分離，並未形成一體，惟證據 2 已揭露各限高柱具有支撐部，提供半導體元件的四角隅部位抵靠之用，其與系爭專利請求項 1 均具有支撐基板四邊角部位之作用

功能，是證據 2 能達成系爭專利所欲解決「現有壓合治具難以對被壓合之物件周邊各角隅處提供足夠之壓合力量而易發生翹曲現象」之問題，原處分已清楚說明證據 2 限高柱支撐部具有支撐基板四邊角部位之作用功能，惟可進一步論述證據 2 能達成系爭專利請求項 1 之「壓合後邊角部位不會翹曲」之功效，加強說明系爭專利並未產生無法預期之功效。

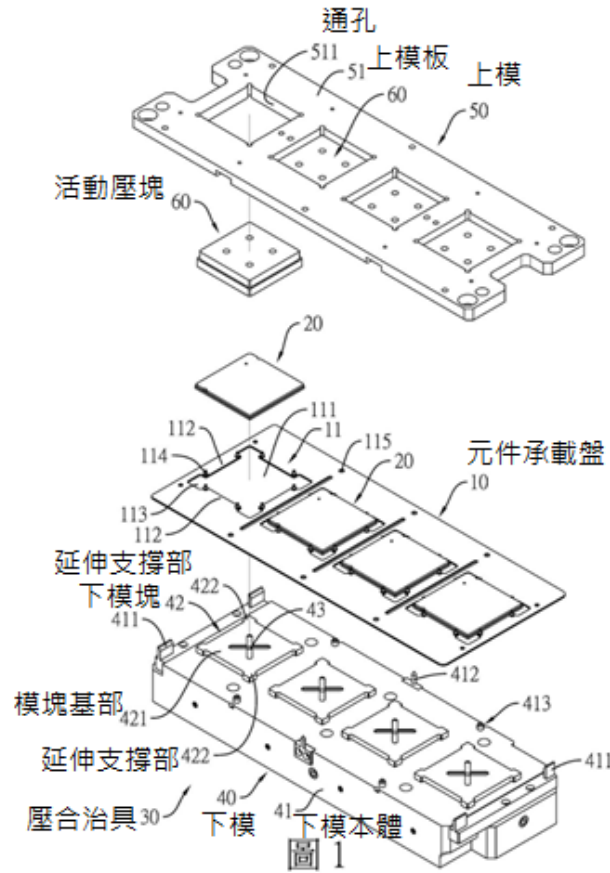
2. 關於進步性之判斷，智慧局見解與法院見解並無二致，惟智慧局於行政訴訟答辯以及出庭時，參考訴願決定書理由進一步補充「證據 2 圖 1 亦揭露下模塊 111 及限高柱 12 相對應壓合位置之上模塊 22 的四個角隅處形成有朝外凸伸之四個凸部 222，因此，系爭專利請求項 1『該四個延伸支撐部分別形成於該模塊基部的四個角隅處且朝外凸伸，該四個延伸支撐部的外周緣實質延伸至所述元件定位區的邊界』之技術特徵，亦是所屬技術領域具有通常知識者再參酌證據 2 相對應壓合之上模塊與凸部之形狀予以簡單變更即能完成者」理由，法院也認同該理由並於判決書之論理中呈現，認定證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性之理由更臻完備。

三、結論與建議

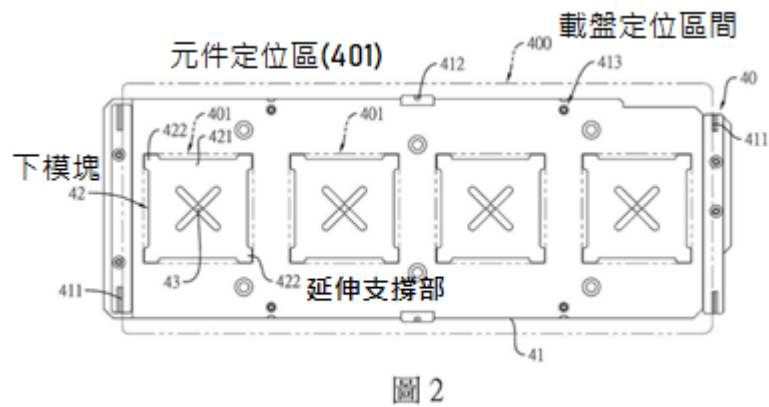
- (一) 由於證據 2 限高柱支撐部與系爭專利請求項 1 延伸支撐部均具有支撐基板四邊角部位之作用功能，亦能達成系爭專利所欲解決「現有壓合治具難以對被壓合之物件周邊各角隅處提供足夠之壓合力量而易發生翹曲現象」之問題，故延伸一體設置支撐部並未產生無法預期之功效，系爭專利請求項 1 之延伸支撐部僅係證據 2 之分離設置支撐部之簡單變更。
- (二) 本件參加人(舉發人)之舉發理由並未主張「證據 2 圖 1 揭露下模塊 111 及限高柱 12 相對應壓合位置之上模塊 22 的四個角隅處形成有朝外凸伸之四個凸部 222」，故智慧局舉發審定理由尚無據以作為論斷的基礎，惟嗣於訴願答辯、行政答辯及言詞辯論時為釐清技術事實，所陳上開專業知識之論理，經言詞辯論，為法院採為立論之基礎，使進步性論理更趨完善，為判決所維持。

四、 附圖

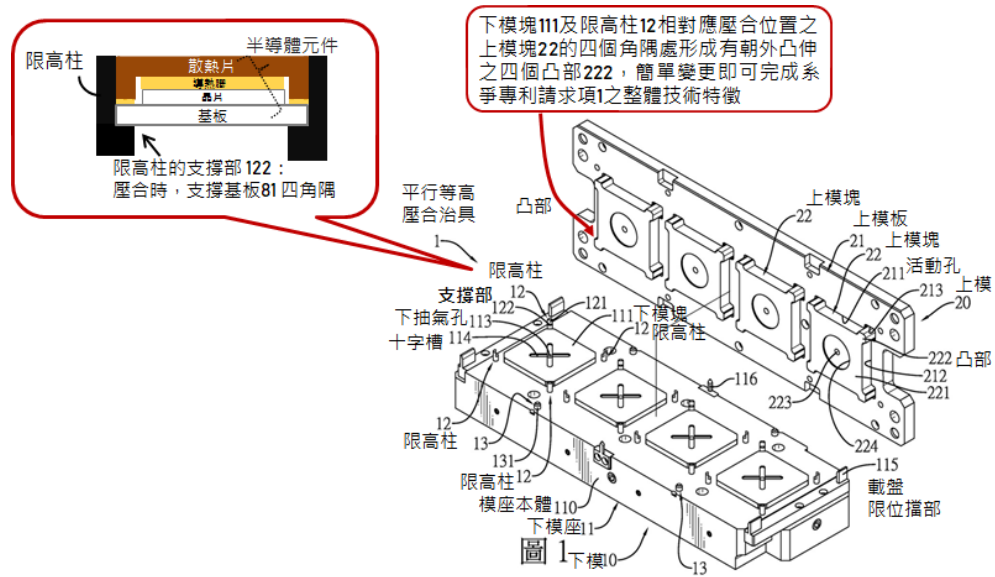
附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 系爭申請案主要圖式



附圖 3 證據 2 主要圖式



附圖 4 證據 2 主要圖式

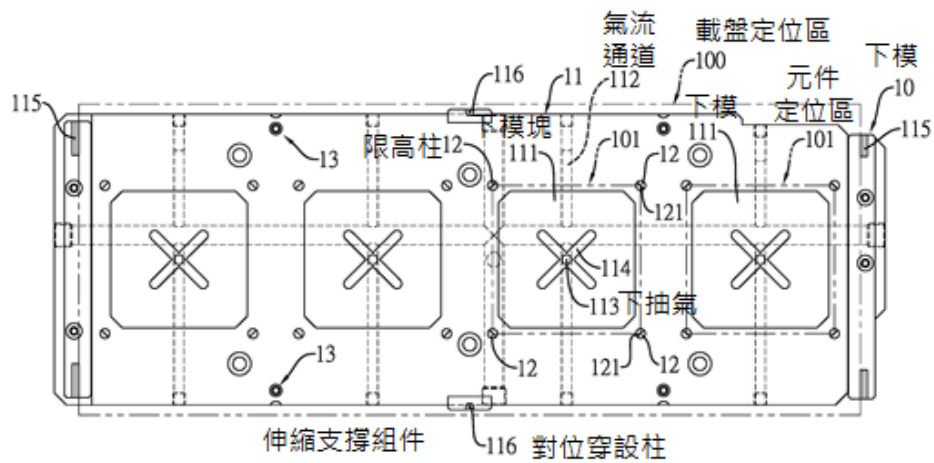


圖 2

附圖 5 證據 3 主要圖式

